

杭州士兰微电子股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：杭州美卡乐光电有限公司、成都士兰半导体制造有限公司（以下分别简称“美卡乐”、“成都士兰”）。美卡乐、成都士兰均为本公司之控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年9月1日至2024年9月30日，公司在年度预计担保额度内为美卡乐签署了担保金额为0.42亿元的最高额担保合同，为成都士兰签署了担保金额为0.30亿元的最高额担保合同。

截至2024年9月30日，公司为美卡乐实际提供的担保余额为1.05亿元，公司为成都士兰实际提供的担保余额为2.98亿元；担保余额均在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。

- 上述担保无反担保。
- 本公司不存在逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）年度预计日常担保进展情况

2024年9月1日至2024年9月30日，公司在年度预计日常担保额度内实际签署的担保合同如下：

担保合同名称	担保合同签署日期	保证人	被担保人	债权人	担保金额	担保方式
本金最高额保证合同	2024年9月30日	杭州士兰微电子股份有限公司	成都士兰半导体制造有限公司	中国建设银行股份有限公司成都岷江支行	担保的本金最高余额为人民币0.30亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保
保证合同	2024年9月3日	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州美卡乐光电有限公司	交通银行股份有限公司杭州东新支行	担保的最高债权额为人民币0.42亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第八届董事会第二十次会议和 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对子公司提供担保的议案》，同意公司在 2024 年度对资产负债率为 70% 以下的主要全资子公司及控股子公司提供日常担保的总额度不超过 29 亿元。实际发生担保时，公司可以在上述预计的担保总额度内，对资产负债率为 70% 以下的不同控股子公司相互调剂使用其预计额度；如在年中有新设控股子公司的，公司对新设控股子公司的担保，也可以在上述预计担保总额度范围内调剂使用预计额度。本次担保预计金额包含以前年度延续至 2024 年度的日常担保余额。本次担保预计额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，且在公司 2024 年年度股东大会召开前，本公司为上述全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内所作出的担保均为有效。股东大会同时授权董事长陈向东先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日和 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临 2024-020、临 2024-026 和临 2024-038。

本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

（三）截至 2024 年 9 月 30 日：

1、公司为美卡乐提供的担保均为日常担保，实际提供的担保余额为 1.05 亿元；公司为成都士兰实际提供的担保余额为 2.98 亿元，其中日常担保余额为 2.42 亿元，专项担保余额为 0.56 亿元；担保余额均在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。

2、公司日常担保余额为 20.32 亿元，剩余可用担保额度为 8.68 亿元。担保余额在公司 2023 年年度股东大会批准的年度预计日常担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

（一）截至 2024 年 9 月 30 日，被担保人的基本情况如下：

公司名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本 (万元)	本公司持股比例 (%)		主营业务
						直接	间接	
杭州美卡乐光电有限公司	91330101689094018G	2009 年 7 月 2 日	浙江杭州	江忠永	17,000	43.00	56.29	LED 封装

成都士兰半导体制造有限公司	91510121564 470905W	2010年11 月18日	四川 成都	陈向东	316,969.70	54.05	硅外延制造；芯片和模块封装
---------------	------------------------	-----------------	----------	-----	------------	-------	---------------

(二) 被担保人美卡乐最近一年及一期的主要财务数据如下：

(单位：人民币 万元)

项 目	2024年6月末/2024年1-6月 (未经审计)	2023年末/2023年度 (经审计)
资产总额	43,099	41,975
负债总额	22,504	22,673
净资产	20,595	19,302
营业收入	17,460	21,180
净利润	1,284	1,224

被担保人成都士兰最近一年及一期的主要财务数据如下：

(单位：人民币 万元)

项 目	2024年6月末/2024年1-6月 (未经审计)	2023年末/2023年度 (经审计)
资产总额	293,462	287,147
负债总额	55,704	64,988
净资产	237,758	222,159
营业收入	34,065	68,618
净利润	-4,411	870

(三) 美卡乐、成都士兰均为本公司的控股子公司，其未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

担保合同名称	保证人	被担保人	债权人	担保金额	担保方式	担保期限
本金最高额保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	成都士兰半导体制造有限公司	中国建设银行股份有限公司成都岷江支行	担保的本金最高余额为人民币 0.30 亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保	按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止
保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州美卡乐光电有限公司	交通银行股份有限公司杭州	担保的最高债权额为人民币 0.42 亿元及其	连带责任保证担保	根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行

	司		东新支行	利息、费用等		承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止
--	---	--	------	--------	--	---

上述担保无反担保。上述担保非关联担保。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项是为了满足控股子公司美卡乐、成都士兰日常生产经营的资金需求,有利于公司主营业务的发展;被担保人美卡乐、成都士兰均为公司合并报表范围内的子公司,具备良好的偿债能力,风险可控。

五、董事会意见

公司于2024年4月7日召开的第八届董事会第二十次会议和2024年5月17日召开的2023年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度对子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于2024年4月9日和2024年5月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告,公告编号为临2024-020、临2024-026和临2024-038。

六、累计对外担保数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司批准对外担保总额为48.066亿元,占公司最近一期经审计净资产的39.98%,其中:公司对控股子公司提供的担保总额为39.85亿元,占公司最近一期经审计净资产的33.15%;公司为厦门士兰集科电子有限公司提供的担保总额为8.216亿元,占公司最近一期经审计净资产的6.83%。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。(担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。)

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024年10月9日